

灿瑞科技：坚持卓越诚信开拓创新 深耕智能传感器芯片和电源管理芯片领域——上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	
上海灿瑞科技股份有限公司董事长 上海灿瑞科技股份有限公司副总经理、董事会秘书 上海灿瑞科技股份有限公司财务总监	罗立权先生 沈美聪女士 宋炯纲先生
中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会执行总经理 中信证券股份有限公司保荐代表人 中信证券股份有限公司保荐代表人	张吉翔先生 谢 雯女士 苗 涛先生

上海灿瑞科技股份有限公司
董事长罗立权先生致辞



尊敬的各位投资者朋友和各位关心灿瑞科技的网友：

大家好！

非常感谢大家参与上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此,我谨代表公司,向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也向多年来一直关心、支持灿瑞科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望,通过此次网上交流活动,充分客观地解答各位投资者所关心的问题,让大家更加全面地了解灿瑞科技。同时,非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！

上海灿瑞科技股份有限公司成立于2005年,始终专注于高性能数模混合集成电路,及模拟集成电路研发设计、封装测试

和销售,长期致力于在智能传感器芯片和电源管理芯片领域,为市场提供应用场景广泛、技术先进的高性能优质产品。

公司目前拥有近600款产品型号,广泛应用于新能源汽车、工业自动化、光伏储能、AIOT等重要领域,助推汽车、工业、医疗及消费等产业快速发展。目前已与国际一线汽车品牌合作,并已被华为、格力、美的、小米、三星等国内外知名品牌纳入合格供应商名录。

灿瑞科技经过17年的自主创新、研发,截至2021年底,累计获得知识产权149项,其中国外专利16项;荣获“工业和信息化部专精特新小巨人”“上海市科技进步二等奖”“中国IC独角兽企业”等多项荣誉,已与上海大学建立联合实验室并与中国科学院半导体研究所夏建白院士合作建立专家工作站,以持续提升技术创新能力。

未来,公司将继续专注于产品研发和技术升级,根据下游客户需求不断优化产品结构,为客户提供性能参数优、可靠性好、稳定性高的智能传感器芯片和电源管理芯片产品。同时,加强对汽车电子、医疗检测、光伏储能等新兴领域核心技术及前沿技术的研究,进一步提升自主研发能力、强化技术研发优势,增强自身的市场竞争力。

希望通过本次交流活动,能让各位投资者对灿瑞科技有更深入、更全面的了解!同时,也希望在公司迈入资本市场后,能够得到各位更多的关注和有力的支持!

最后,欢迎大家踊跃提问,谢谢大家!

中信证券股份有限公司
全球投资银行管理委员会执行总经理
张吉翔先生致辞



尊敬的各位嘉宾,投资者朋友们：

大家好！

作为本次发行的保荐机构和主承销商,我谨代表中信证券股份有限公司,对今天参加上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

自成立以来,灿瑞科技深耕智能传感器芯片和电源管理芯片领域,凭借多年来的研究积累,已成功研发了多项具备自主知识产权的核心技术,主要产品性能达到国际先进水平,产品已导入智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、智能安防、工业

控制和汽车电子等众多领域的知名品牌终端产品,包括格力、美的、海尔等智能家居品牌,漫步者、JBL等可穿戴设备品牌,海康威视等智能安防品牌,Danfoss、英威腾等工业设备品牌,小米、传音、三星、LG、OPPO、vivo和联想等行业知名品牌手机,公司磁传感器芯片已导入国际新能源汽车供应链。公司主要产品在市场中建立了一定的品牌知名度和美誉度。

公司目前已建立“Fabless+封装测试”的经营模式,2021年全资子公司恒拓电子投产运营后,公司的封装测试能力进一步完善和扩充,在研发、生产、质量方面与芯片设计业务方面形成了显著的协同效应,进而整合集成电路产业链并构筑了差异化的行业壁垒。

作为灿瑞科技科创板IPO的保荐机构,我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信灿瑞科技在科创板上市后,将一如既往地不断提升公司的自主研发和创新能力,不断提高公司的经营管理水平和盈利能力,给广大投资者带来丰厚回报!

最后,预祝灿瑞科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功!谢谢大家!

上海灿瑞科技股份有限公司
副总经理、董事会秘书沈美聪女士致结束语



尊敬的各位投资者和各位网友：

大家好！上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此,我谨代表灿瑞科技全体员工,感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问,同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服

务。另外,我还要感谢中信证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力。谢谢你们！

通过今天的网上路演活动,我们对灿瑞科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对灿瑞科技的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任,灿瑞科技将以首发上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

最后,希望我们携手共进,创造和分享属于灿瑞科技更加美好的未来!谢谢大家!



经营篇

问:请介绍公司主营业务的情况。

罗立权:公司是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。公司在建立完善的集成电路设计技术体系的同时,拥有全流程集成电路封装测试服务能力,涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节,为公司主营业务产品提供质量和产能保障,为公司持续快速发展奠定良好基础。公司秉持自主创新的理念,持续进行研发投入,主要产品的技术性能已达到国际先进水平,广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等众多国民经济重要领域。

问:请介绍公司的主要产品和服务。

罗立权:经过长期自主研发和技术积累,公司目前已形成芯片设计及封装测试服务两类相互协同的业务布局。其中,芯片设计业务已形成两大板块、六大系列、550余款的丰富产品体系。两大板块产品为智能传感器芯片和电源管理芯片,其中智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片,电源管理芯片主要包括屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片、LED照明驱动芯片、功率驱动芯片。

问:请介绍公司的技术成果及产业化应用情况。

罗立权:公司研发成果丰富,截至2021年12月31日,已取得境外专利16项(其中发明专利12项),境内专利63项(其中发明专利27项),集成电路布图设计专有权63项,软件著作权7项;公司与上海大学建立了联合实验室,与中国科学院半导体研究所合作建立院士专家工作站,持续进行自主创新与技术升级。

公司技术实力得到广泛认可,是“工业和信息化部专精特新小巨人”“上海市科技小巨人企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市专利试点企业”和上海市集成电路行业协会理事单位;公司的“高性能磁传感器系统及芯片关键技术的研发和应用”课题于2020年荣获上海市科技进步奖二等奖。此外,公司的“双极锁存型霍尔开关电路”“非隔离准谐振降压LED恒流驱动器”“数字I2C通讯接口LCD屏幕偏压驱动器”“数字一线通讯接口双路大电流LED闪光驱动器”和“H桥电机驱动器”产品为上海市高新技术转化项目。

问:公司有多少商标?

罗立权:截至2021年12月31日,公司拥有13项注册商标。

问:公司承担的科研项目有哪些?

罗立权:近年来,公司承担的科研项目包括:2020年度张江专项、2019年静安区发改委综合改革试点专项资金、2018年青年科技启明星计划、2017年度软件和集成电路专项和2016年度张江专项。

问:公司营业收入的构成如何?

宋炯纲:2019年度至2021年度,公司营业收入分别为19863.14万元、28969.77万元和53719.43万元,营收规模持续增长。公司营业收入主要源于主营业务,2019年度至2021年度,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为96.30%、98.38%和99.40%。

问:公司产品的综合毛利和综合毛利率是多少?

宋炯纲:2019年度至2021年度,公司综合毛利分别为6674.68万元、11028.95万元和23219.10万元,综合毛利率分别为33.60%、38.07%和43.22%,均呈现逐年增长趋势。

问:公司的研发费用是多少?

宋炯纲:2019年度至2021年度,公司的研发费用分别为1595.22万元、2620.08万元和5754.62万元。

发展篇

问:公司整体的发展战略是什么?

谢雯:公司长期致力于在智能传感器芯片和电源管理芯片领域为市场提供应用场景广泛、技术先进的高附加值产品,以核心技术创新为国产集成电路产业发展作出贡献,响应国家战略号召。未来,公司将继续坚持“卓越、诚信、开拓、创新”的企业文化,始终专注于产品研发和技术升级,并根据下游客户需求不断优化产品结构,为客户提供性能参数优、可靠性好、稳定性高的智能

传感器芯片和电源管理芯片产品,进一步巩固和提高公司在行业中的市场地位。同时,公司未来将通过募投项目建设,加强对汽车电子、医疗检测、定位导航等新兴领域基础核心技术及前沿技术的研究,进一步提升自主研发及创新能力、强化技术研发优势、增强自身的市场竞争力。

问:为了更好地实现发展规划和目标,公司将采取哪些具体的计划与措施?

谢雯:将采取的计划与措施有:1)技术和产品的持续研发创新;2)持续开拓市场;3)加强人才培养与引进、优化管理体系;4)实施多元化融资的计划。

问:公司的竞争优势有哪些?

罗立权:公司的竞争优势有:

1)出色的研发能力,产品核心技术处于领先水平。在智能传感器芯片领域,公司基于“嵌入式集成磁传感器智能H桥驱动电路设计技术”“基于主动式虚通道可编程参数配置的磁传感系统芯片架构技术”“低功耗CMOS传感器信号处理技术”等核心技术,形成超过200款磁传感器芯片产品,完成了高可靠性、高精度、低噪声、超低功耗、集成化等关键技术突破,主要产品的技术性能达到国际先进水平,可以与国际知名磁传感器芯片厂商的同类产品竞争。同时,公司紧跟光传感器芯片的前沿研发方向,把握结构光技术和TOF技术下光源芯片的发展趋势,成功研发出符合市场需求的IR和VCSEL发射器及驱动芯片,且已应用于智能安防和人脸支付领域知名厂商的产品中。

2)建立“Fabless+封装测试”业务模式,通过产业链协同为公司可持续发展赋能。在“Fabless+封装测试”的经营模式下,公司建设自有封装测试生产线,在研发、生产、质量方面与自身研发设计方面形成了显著的协同效应。

3)良好的品牌美誉度,核心产品覆盖不同领域的知名客户。公司凭借自身优异的产品性能和可靠的产品质量,核心产品覆盖了多产业链的知名客户。其中,智能传感器芯片在功耗、精度及可靠性等技术性能方面均表现优异并获得客户认可,广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等知名品牌产品中;在电源管理芯片方面,公司凭借优良的电流精度、带载能力、输出效率,奠定了电源管理产品的市场地位,产品已广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、vivo、传音、荣耀等行业知名品牌产品中。

4)产品种类丰富,能够满足不同领域不同客户的多样化需求。公司的产品种类丰富,包括智能传感器芯片和电源管理芯片两大板块、六大系列、550余款产品型号,可满足智能家居、智能手机、计算机和可穿戴设备等不同领域终端客户在不同使用场景的应用需求。

问:公司面临的机遇有哪些?

罗立权:近年来,国家各部门相继推出了一系列政策,鼓励和支持集成电路行业发展。集成电路行业飞速发展,公司面临着良好的发展机遇。公司将不断进行研发投入,紧跟下游市场和趋势,持续提升经营业绩。

集成电路下游市场空间巨大,随着物联网、5G通信、人工智能等新技术的不断成熟,消费电子、工业控制、汽车电子、计算机周边等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快,催生了集成电路市场的增量需求。同时,5G技术、VR(虚拟现实)和AR(增强现实)等新兴技术带动下游终端电子产品加速更新换代,以平板电视、笔记本电脑、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,进而促进了公司不断发展。

问:公司如何保持及推动技术创新?

罗立权:为保持及推动技术创新,公司采取的措施有:1)完善研发管理机制;2)建立人才培养与激励机制;3)加大研发投入;4)加强知识产权管理;5)开展技术合作研发。

行业篇

问:公司所属行业及确定所属行业的依据是什么?

罗立权:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

问:集成电路行业的发展趋势如何?

罗立权:发展空间广阔。近年来,中国已成为

全球规模最大、增速最快的集成电路市场,但国内需求多通过进口满足,尤其以高端芯片的需求缺口较大。根据海关总署统计的数据,中国2021年集成电路进口额达4325.54亿美元,而出口额仅为1537.90亿美元,中国在集成电路领域具备庞大的发展空间。为此,政府及相关部门出台了大量法规、政策,推动集成电路发展。

应用场景逐渐丰富。目前传感器芯片和电源管理芯片已广泛应用于智能手机、智能家居等领域,未来,随着5G设备商用化的落地、智能网联汽车领域的强劲发展以及数字化智能化生活的普及,传感器芯片和电源管理芯片在通信领域、汽车电子领域和消费领域的需求有望持续增长。

产品集成度不断提高。集成电路产品的下游应用,尤其是智能手机、平板、计算机和智能家居等领域,对产品重量、厚度有着较高的要求。为实现这一目标,集成电路厂商一方面需要改进芯片的结构设计、优化内部器件布局和制造工艺,进而缩小产品大小,从而在单片晶圆尺寸固定的情况下,产出更多的芯片数量,最终降低产品单位成本;另一方面,集成电路厂商可以根据终端需求灵活选择封装形式,在保证产品性能的基础上缩小成品芯片的尺寸。

问:请介绍集成电路行业的市场竞争格局以及公司的市场地位。

罗立权:由于我国集成电路产业起步相对较晚,而国际大型集成电路企业如TI等拥有较强的研发能力,目前仍在市场内占据主要地位。根据IC Insights出具的研究报告,2020年中国集成电路市场规模为1434亿美元,其中,国产芯片的市场占比为5.8%。但随着中国经济水平的快速发展和国家政策的持续扶持鼓励,国内企业的技术水平持续提升,在部分细分市场领域已追赶国际领先水平。

公司自设立以来深耕智能传感器芯片和电源管理芯片领域,凭借多年来的研究积累,已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术,主要产品性能达到国际先进水平,产品已导入智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、智能安防、工业控制和汽车电子等众多领域的知名品牌终端产品,包括格力、美的、海尔等智能家居品牌,漫步者、JBL等可穿戴设备品牌,海康威视等智能安防品牌,Danfoss、英威腾等工业设备品牌,小米、传音、三星、LG、OPPO、vivo和联想等行业知名品牌手机,以及蔚来、龙旗、华勤、中诺等智能硬件ODM企业。公司主要产品在市场中具有一定竞争力,建立了一定的品牌知名度和美誉度。

问:行业内的可比公司有哪些?

罗立权:行业内并无业务模式和产品类型与公司完全相同的可比公司。在智能传感器芯片领域,同行业可比公司有ALLEGRO、MELEXIS、圣邦股份、纳芯微;在电源管理芯片领域,同行业可比公司有德州仪器、炬力杰、芯朋微、艾为电子、晶丰明源、明微电子、富满微、希荻微。

发行篇

问:公司本次发行多少股?

张吉翔:公司本次拟发行1927.68万股。

问:公司募集资金投资项目有哪些?

张吉翔:经公司第二届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过,本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目、专用集成电路封装建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

问:请介绍公司进行现金分红的具体条件。

沈美聪:公司现金分红应满足以下条件:1)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行);2)公司该年度或半年度实现的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;3)公司累计可供分配利润为正值;4)公司无重大投资计划或重大资金支出等事项(指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上);5)法律法规、规范性文件规定的其他条件。